



# 半导体行业专用压力开关 CB14

## 概述

这是一种简单、体积小、重量轻的压力开关，专为半导体行业各种气体应用而设计，在制造此产品时，充分考虑了清洁度和气密性，并通过严格的质量控制和性能测试，因此，该压力开关适合用于测量半导体工业的高纯度气体。

## 特征

- 体积小、重量轻、节省安装空间。
- 压力设定简单易操作。
- 由于微动开关机构没有过多的负载，所以可保证稳定控制。
- 清洗和装配在洁净室的净化工作台（100级）完成，确保其洁净度，脱脂处理是采用氟利昂超声波清洗完成，禁油、禁水处理也适用，所有工序完成后，产品被包装在一个密封防尘的聚乙烯袋中。
- 接气部隔膜采用电解研磨处理。

※ 为延长产品使用寿命，请将设定压力置于压力范围的30%~60%之间。

※ 同时请确认接液部材质是否适用于被测介质。

## 规格 1

### 测量介质:

各种过程气体

### 压力元件:

波纹管或隔膜（电解研磨）

### 接气部材质:

SUS316, SUS316L

### 连接口径:

1/8NPT、1/4VCR（9/16-18UNF外螺纹·内螺纹）

### 压力范围:

-0.1~0.2→-0.1~2.1MPa

### 使用温度范围:

-5~40°C

### 保存温度范围:

-5~40°C

### 精度:

±1%max.P以内（量程范围：±1%F.S.以内）

### 电气特性:

容量 125, 250V AC 15A

耐电压 1500V AC 1分钟（壳体与端子间）

绝缘电阻 500V DC 高阻表 100MΩ以上

### 开关:

微动开关

### 接点数:

1接点

### 接点方式:

外部调整式

### 电缆连接方法:

与微动开关端子直接相连（M4端子）

### 气密性:（He真空法）

$1.01 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 以下

### 防护等级:

室内用

### 壳体颜色:（开关安装夹具和本体）

镀镍

### 重量:

约160g~约270g

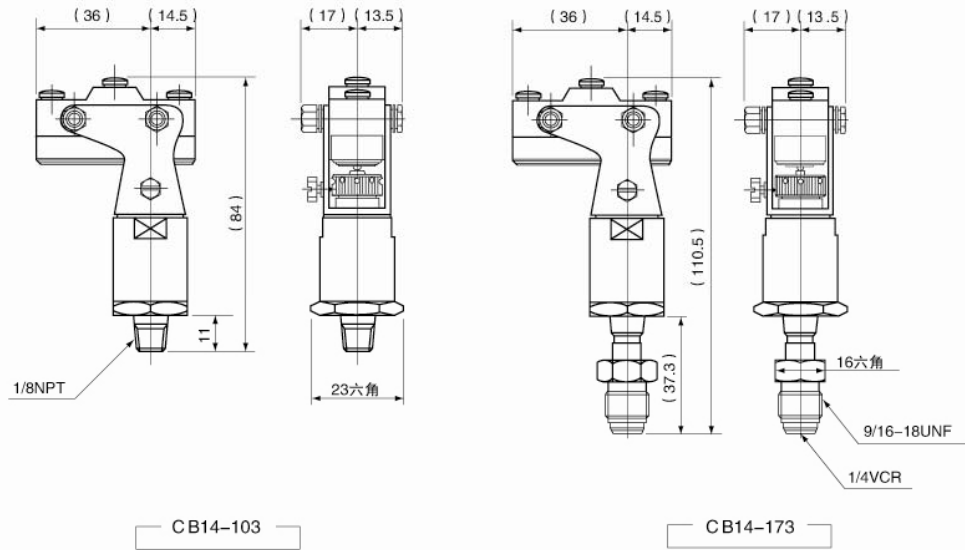
规格 2

最大允许压力&接断差

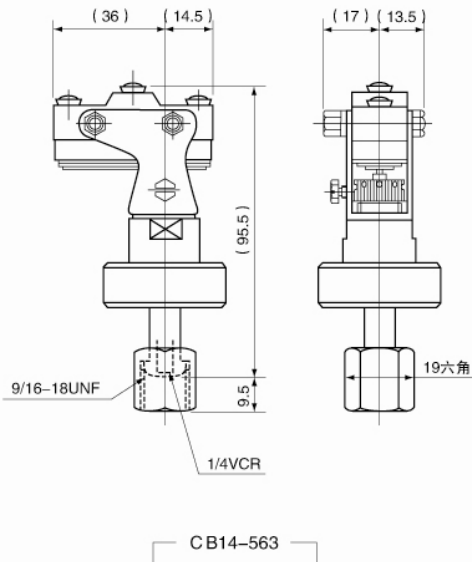
压力范围 MPa	最大允许压力MPa	接断差 MPa
0.02 ~ 0.35	0.53	0.021以下
0.035 ~ 0.7	1	0.021以下
0.1 ~ 2.1 ※ CB14-563 不可选 (隔膜式)	2.5	0.042以下
-0.1 ~ 0.2	0.3	0.021以下

外形尺寸

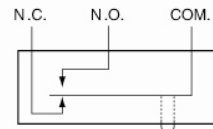
波纹管式



隔膜式



接线:



注意事项

在一般条件下使用，不能用于存在易燃气体或液体的场合。

# 半导体行业专用压力开关CB14

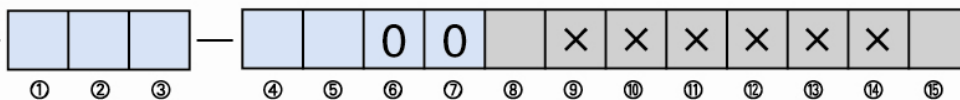
## 选型规格

选型时请指定型号、规格、压力范围

型号

CB14

半导体行业专用压力开关



基本型号		基本选型		可选项	
①②③	103	波纹管式	接口螺纹: 1/8NPT		
	173	波纹管式	接口螺纹: 1/4VCRオス (9/16-18UNF)		
	563	隔膜式	接口螺纹: 1/4VCRメス (9/16-18UNF)		
④	压力范围 (MPa)	1	0.02~0.35		
		2	0.035~0.7		
		3	0.1~2.1 波纹管式可制作		
		4	-0.1~0.2		
⑤	接点形式	A	H: 上限1接点		
		B	L: 下限1接点		
		F	HR: 逆上限式1接点		
		G	LR: 逆下限式1接点		
⑥	开关	0	标准型 标准型微动开关		
⑦	电线连接	0	标准 (M4端子)		
⑧	可选项	0	无		
		1	带微动开关盖子		
⑮	资料	0	无		
		1	其他 (请单独标明需求的文件) 图纸、使用说明书、检查要领书、制造工艺流程表、检测报告 (每个产品1份) 检查/可追溯证明		